

Singulation System

Model FMS3040-FC



Singulation system for cutting substrates

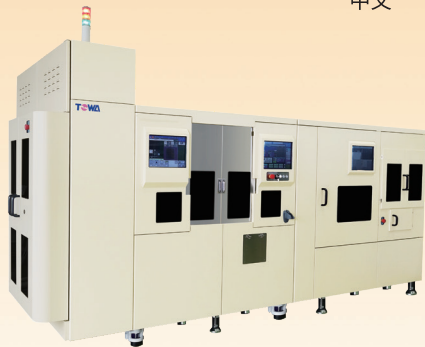
基板切割专用的切割设备

- 仅需一台设备即可实现从切割到清洗／干燥、外观检测、最终收纳于托盘的全自动化生产
- 适用于切割倒装芯片基板
- 适用于最大尺寸为W242 × L322.5 × t2.5mm的基板
- 通过最佳的搬送单元和切割处理单元实现高精度切割，以满足客户需求
- 标准的外观检查功能和根据基材厚度自动聚焦

产品信息



中文



SPECIFICATION

Items		Unit	Description	
机型		—	FMS3040-FC	
设备区分		—	Tray type	
框架・基板尺寸	长度	mm	267.2—322.5	
	宽度	mm	150—242	
	厚度	mm	0.6—2.5	
产品尺寸	最小	mm	12×12	
	最大	mm	60×60	
基板翘曲量		—	2mm／200mm (Max.)	
切割引擎		—	Twin spindles, Twin tables	
外形尺寸	机类型	module	Cut Engine	Offload
	宽度	mm	2,255	1,625
	纵深	mm	1,760	1,760
	高度	mm	2,200	1,800
重量		ton	5.4	
框架・基板供给部	类型	—	Slit magazine	
	数量	pcs	2 (Max.) 当弹匣宽度为320毫米时	
产品收纳机构	类型	—	JEDEC Tray	
	数量	pcs	50 (Max.)	
吸嘴数量		—	2units×7pcs (Option: 2units×11pcs)	
品种转换件更换时间		min	15	
产品传送方式		—	Vacuum	
产品处理能力		UPH	730	

- ・ 以上数据为本公司标准机型时的规格
- ・ 以上规格根据实际需要有改良变更的可能
- ・ 如有其他特殊规格要求，另行协商



东和半导体设备（上海）有限公司
中国上海市普陀区凯旋北路1188号环球港B座20A
TEL 021-6888-6860

Website



Inquiry contact



TOWA（本公司商标），是TOWA株式会社的商标或注册商标。

Overseas Sales Contacts

Japan/Headquarters

TOWA Corporation

China

TOWA (Shanghai) Co., Ltd.
TOWA Taiwan Co., Ltd.

Korea

TOWA Korea Co., Ltd.

Singapore

TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.

Malaysia

TOWA Malaysia Sales & Services Sdn. Bhd.

Philippines

TOWA Semiconductor Equipment
Philippines Corp.

Thailand

TOWA THAI COMPANY LIMITED

India

TOWA SEMICONDUCTOR INDIA
PRIVATE LIMITED

Germany

TOWA Europe GmbH

Netherlands

TOWA Europe B.V.

the United States

TOWA USA Corporation

20250401-004-HQ